

SK9810MICRO

2.4x2.7x1.1毫米 0.15W 智能外控单线高灰表
面贴装SMD型LED (MSL: 5a)



修订记录

日期	Rev. No.	修改/改变的原因	签名
2019-12-25	01	首次发行	KEVIN ZHU

*使用我司产品前, 请检索我司官网核对规格书版本, 产品规格书版本更新, 恕不能及时相告, 请以官网最新资料为准;

*该版权及产品最终解释权归深圳市诺曼德电子有限公司所有, 如有特殊规格要求, 请联系我司工程人员;

*官网: <http://www.normandled.com>

目 录

1、产品概述	3
2、主要应用	3
3、特征说明.....	3
4、机械尺寸.....	3
5、引脚功能说明.....	4
6、PCB 建议焊盘尺寸.....	4
7、产品命名一般说明.....	4
8、电气参数.....	5
9、RGB LED光电参数.....	5
10、IC电气参数.....	5
11、内部功能框架.....	6
12、开关特性.....	6
13、 数据传输时间.....	7
14、时序波形图.....	7~9
15、恒流特性.....	10
16、典型应用电路.....	11
17、光电特性.....	12
18、包装标准.....	13
19、可靠性测试.....	14
附录1.表面贴装型LED使用注意事项.....	15~19

深圳市诺曼德电子有限公司

Shenzhen Normand Electronic Co.,Ltd

1.产品概述:

SK9810MICRO是一款单线传输三通道 (RGB)驱动控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。产品内含有信号解码模块、数据缓存器、内置恒流电路及RC振荡器；内部集成电流增益控制模块，CMOS制程，低压、低耗电；三通道恒流驱动器默认输出9mA, 采用单线输出方式，串接各晶片之输出动作同步；上电默认不亮灯。数据协议采用单极性归零码的通讯方式，单线传输LED驱动控制专用芯片，同时芯片内置的电流增益调节功能，可设置电流0.25mA~9.0mA,共16个电流增益等级；

通道数据输出16 bit 灰度数据，输出真实 65536级。PWM信号刷新率高达4KHz,显示更趋细腻平滑,解决拍摄画面暗条纹问题；

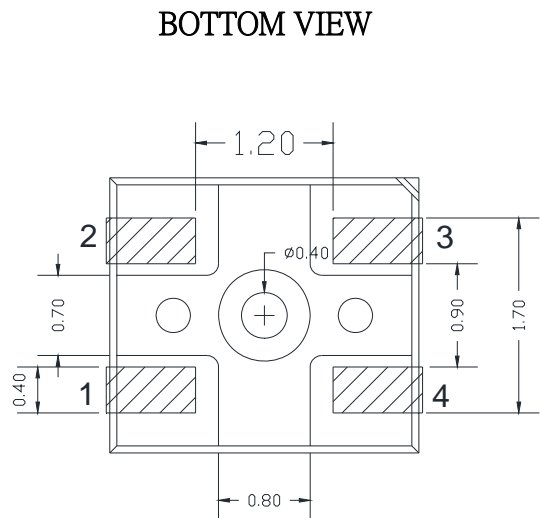
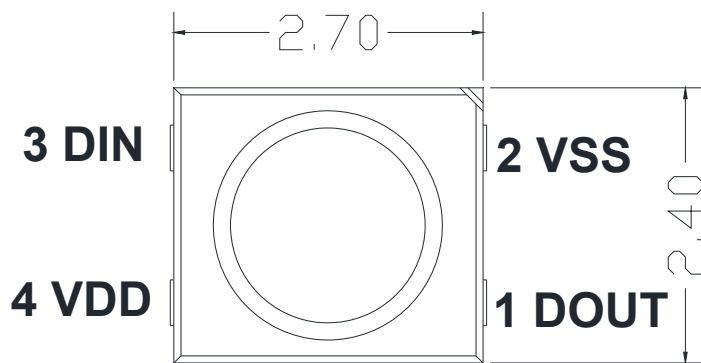
2.主要应用:

- LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED幻彩软硬灯条,LED护栏管,LED外观/情景照明
- LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。

3.特性说明:

- Top SMD内部集成高质量串行级联恒流IC；5V电源应用；默认上电不亮灯；内置电源稳压电路。
- 控制电路与芯片集成在SMD 2427元器件中，构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀且一致性高。
- 单线式同步控制，内置单向传输功能，级联数据整形后输出；防止数据衰减；
- OUTR/G/B各4bits电流增益调节位，灰度调节电路；
- 三路恒流驱动，内置高精度及高稳定性振荡器，电流误差 $\leq\pm 5\%$ 。
- 内置PWM专利技术，刷新率可达4KHz,信号传输速率达800Kbps。
- 数据传输方式：Trst+1st 48bits+2nd 48bits+.....+ N 48bits+16bit 电流增益数据+Reset 数据,电流增益数据，发送电流增益数据时，均需发送16bits电流增益调节位，发送RGB三色电流增益位时，保留位的4bits增益数据也随机填入，但不能为空；可发送任意数据。
- 产品支持支持动态节能模式（自动启停）；
- 产品支持超低功耗待机模式；

4.机械尺寸:



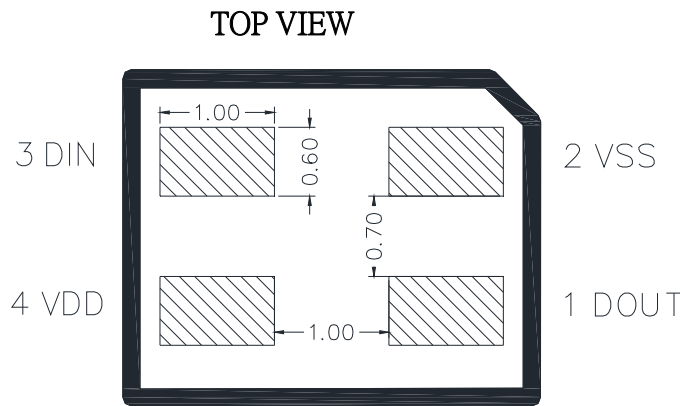
备注:

1. 以上标示单位为毫米.
2. 除非另外注明，尺寸公差为 ± 0.1 毫米.

5. 引脚功能说明

序号	符号	管脚名	功能描述
1	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
2	VSS	地	信号接地和电源接地
3	DIN	数据输入	控制数据信号输入
4	VDD	电源	供电管脚

6. PCB建议焊盘尺寸



7. 产品命名一般说明

SK 9810-MICRO-X-X

① ② ③ ④ ⑤

①	②	③	④	⑤
系列	IC系列与电流代码	封装外形	PPA表面颜色	封装胶颜色
默认为RGB晶片与 IC集成在一起	指9810系列IC XX: 包括0.25-9.0MA 电流版本 (电流可调)	2.4x2.7x1.1 毫米外形	B: 表示黑面 W: 表示白面, 一般不标示	D: 表示扩散/磨砂 W: 表示透明, 不标示

8. 电气参数（极限参数， $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$ ）：

参数	符号	范围	单位
电压电压	V_{DD}	3.7~+5.5	V
逻辑输入电压	V_{IN}	-0.4~ $V_{DD}+0.4$	V
工作温度	T_{opt}	-20~+85	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	-20~+85	$^{\circ}\text{C}$
ESD耐压（设备模式）	V_{ESD}	200	V
ESD耐压（人体模式）	V_{ESD}	2K	

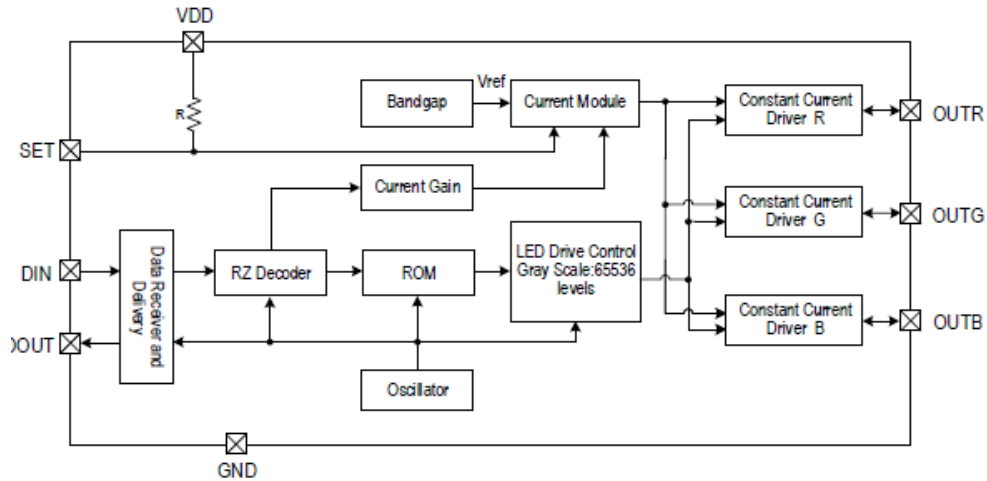
9. RGB LED 特性参数:

颜色	波长(nm)	发光强度(mcd)	流明 (lm)
红色 (Red)	620-630	160-320	0.5-1.0
绿色 (Green)	515-530	580-1050	1.8-3.3
蓝色 (Blue)	460-475	80-320	0.25-1.0

10. 电气参数（如无特殊说明， $T_A=-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ， $V_{DD}=5.0\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$ ）：

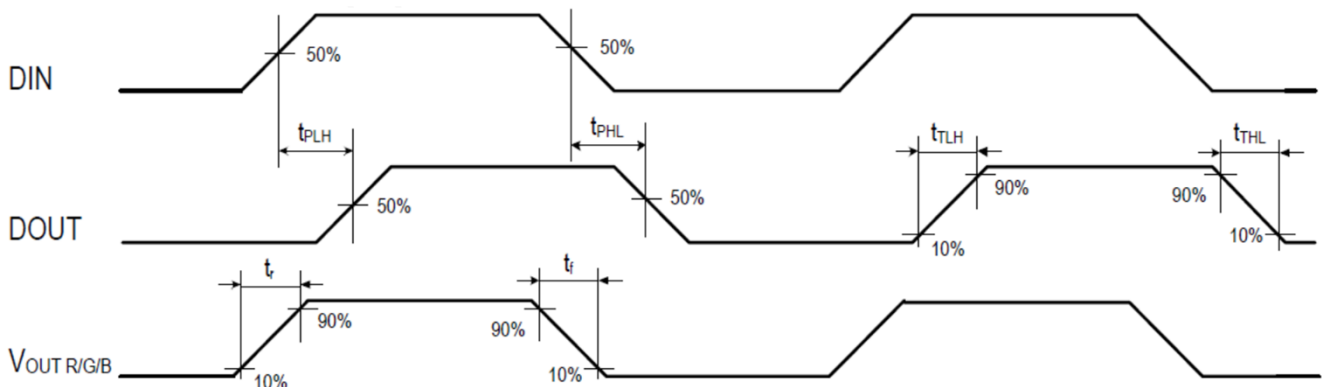
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片内部电源电压	V_{DD}	---	5.2	---	V	---
静态功耗	I_{DD}	---	0.13	---	mA	$V_{DD}=4.5\text{V}$, I_{out} "OFF"
信号输入翻转阈值	V_{IH}	$0.7*V_{DD}$	---	---	V	$V_{DD}=5.0\text{V}$ DIN或DOUT
	V_{IL}	---	---	$0.3*V_{DD}$	V	
OUTR/G/B/W端口驱动电流	I_{out}	0.25	---	9.0	mA	$V_{DS}=2\text{V}$, 电流增益设置 0000~1111
PWM频率	F_{PWM}	---	4.0	---	KHZ	---
OUT R/G/B漏电流	I_{leak}	---	---	1	μA	$V_{DS}=15\text{V}$, I_{out} "OFF"
OUTR/G/B恒流拐点电压	V_{DS-S}	---	0.5	---	V	$I_{OUT}=2.5\text{mA}$
		---	0.6	---	V	$I_{OUT}=6\text{mA}$
		---	0.7	---	V	$I_{OUT}=9\text{mA}$
OUTR/G/B端口电流变化量	$\%VS.V_{DS}$	---	1.0	---	%	$V_{DS}=1\sim3\text{V}$, $I_{OUT}=9\text{mA}$
	$\%VS.V_{DD}$	---	1.0	---	%	$V_{DD}=4.0\sim5.2\text{V}$, $I_{OUT}=9\text{mA}$
	$\%VS.Temp.$	---	---	6.0	%	$I_{OUT}=9\text{mA}$, $Temp=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$

11. 内部功能框架



12. 开关特性 (VCC=5V, Ta=25°C) :

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
The frequency of PWM	F_{PWM}	---	4.0	---	KHZ	$I_{OUT}=9mA$, OUT R/G/B端口串接200Ω电阻至VDD
DOUT传输延迟	T_{PLH}	---	100	---	ns	DOUT端口对地负载电容30pF, DIN至DOUT的信号传输延时
	T_{PHL}	---	100	---	ns	
DOUT转换时间	T_{TLH}	---	20	---	ns	DOUT端口对地负载电容30pF
	T_{THL}	---	10	---	ns	
OUT R/G/B 转换时间	t_r	---	20	---	ns	$I_{OUT}=9mA$, OUT R/G/B端口串接200Ω电阻至VDD, 对地负载电容15pF.
	t_f	---	20	---	ns	



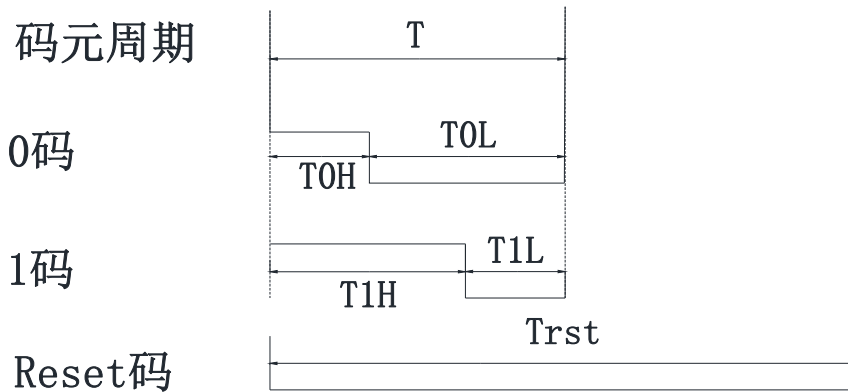
13. 数据传输时间:

时序表名称	Min.	实际值	Max.	单位
T	码元周期	1.20	--	μs
T0H	0码, 高电平时间	0.2	0.30	μs
T0L	0码, 低电平时间	0.8	0.9	μs
T1H	1码, 高电平时间	0.8	0.9	μs
T1L	1码, 低电平时间	0.2	0.3	μs
Trst	Reset码, 低电平时间	>200	--	μs

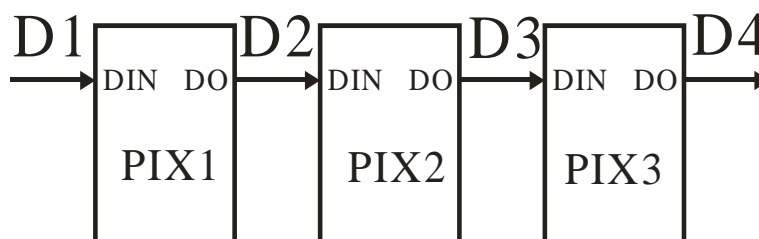
1. 协议采用单极性归零码，每个码元必须有低电平，本协议的每个码元起始为高电平，高电平时间宽度决定“0”码或“1”码。
2. 书写程序时，码元周期最低要求为1.2μs。
3. “0”码、“1”码的高电平时间需按照上表的规定范围，“0”码、“1”码的低电平时间要求小于20μs。

14. 时序波形图 (Ta=25°C):

输入码型:



连接方式:



深圳市诺曼德电子有限公司

Shenzhen Normand Electronic Co.,Ltd

(2) 协议数据格式：

RGB三色灯珠应用数据格式：

**Trst+ 第一颗芯片48bits数据+ 第二颗芯片48bits数据+.....+ 第N颗芯片48bits数据+16bits电
流增益数据+Trst**

- **48bits 灰度数据结构：高位在前，按照RGB的顺序发送**

G15	G14	G13	G12	G11	G10	G9	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R15.....R0	B15.....B0
Bits47.....bits0																	

- 系统拓扑图：



- 各芯片输入数据流（以3颗芯片为例）：

芯片1	Trst	第一组48bits数据	第二组48bits数据	第三组48bits数据	16bits 电流增益数据	Trst		
芯片2	Trst		第二组48bits数据	第三组48bits数据	16bits 电流增益数据	Trst		
芯片3	Trst			第三组48bits数据	16bits 电流增益数据	Trst		

深圳市诺曼德电子有限公司

Shenzhen Normand Electronic Co.,Ltd

(3) 电流增益调节参数：

电流增益数据共16bits,包含保留位4bits和红绿蓝灯电流增益调节位各4bits,分别对应4bits(S3-S0),系统发送顺序是先发红灯4bits,然后是绿灯的4bits,再发蓝灯的4bits,最后发保留位4bits,先发高位S3,最后发低位S0.

电流增益参数发送格式			
红灯 (R)	绿灯 (G)	蓝灯 (B)	保留位
S3, S2, S1, S0	S3, S2, S1, S0	S3, S2, S1, S0	S3, S2, S1, S0

注：保留位数据不影响电流增益调节，但发送数据时不能留空，必须填满数据位，可发送任意数据。

OUT R/G/B最大输出9mA电流，同时用户可通过改变电流增益数值设置其它电流值，具体电流值参考下表

电流调节等级	电流增益调节位				对应电流值 (mA)
	S3	S2	S1	S0	
1	0	0	0	0	0.25
2	0	0	0	1	0.85
3	0	0	1	0	1.4
4	0	0	1	1	2.0
5	0	1	0	0	2.6
6	0	1	0	1	3.15
7	0	1	1	0	3.75
8	0	1	1	1	4.35
9	1	0	0	0	4.9
10	1	0	0	1	5.5
11	1	0	1	0	6.1
12	1	0	1	1	6.65
13	1	1	0	0	7.25
14	1	1	0	1	7.85
15	1	1	1	0	8.4
16	1	1	1	1	9.0

注：1、建议使用电流：1~9电流调节等级

2、基于产品散热，此款产品电流建议最大使用为：4.9mA，电流调节等级10~16级不建议使用

● 待机模式说明

(1) 上电默认进入待机模式，接收到 DIN 任意数据后唤醒,即可正常显示控制

(2) 在正常显示控制时，如需进入待机模式，16 位电流增益数据需发以下格式发送待机指令：

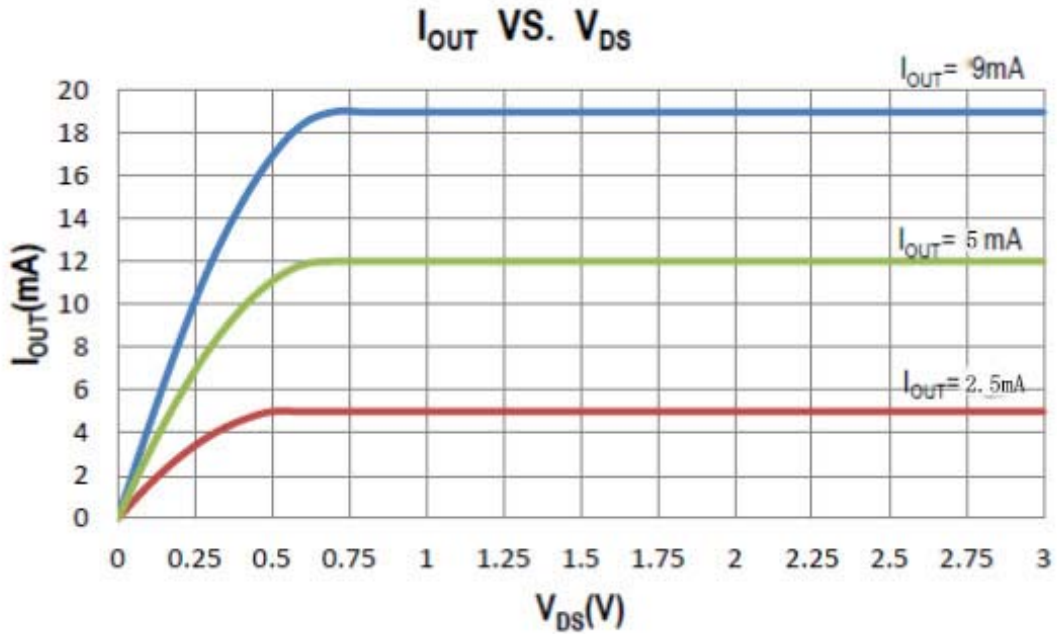
GR3	GR2	GR1	GR0	GG3	GG2	GG1	GG0	GB3	GB2	GB1	GB0	S3	S2	S1	S0
GR3	GR2	GR1	GR0	GG3	GG2	GG1	GG0	GB3	GB2	GB1	GB0	0	0	1	1

说明：待机模式下，OUT 端口关闭。

15. 恒流特性：

(1)：恒流曲线图

达到恒流拐点后，SK9810输出电流不受OUT端口电压 V_{DS} 影响。



(2)：输出电流设置

芯片 OUTR/G/B 最大输出电流值 9mA，亦即电流增益为 16 级时，电流最大值为 9mA。

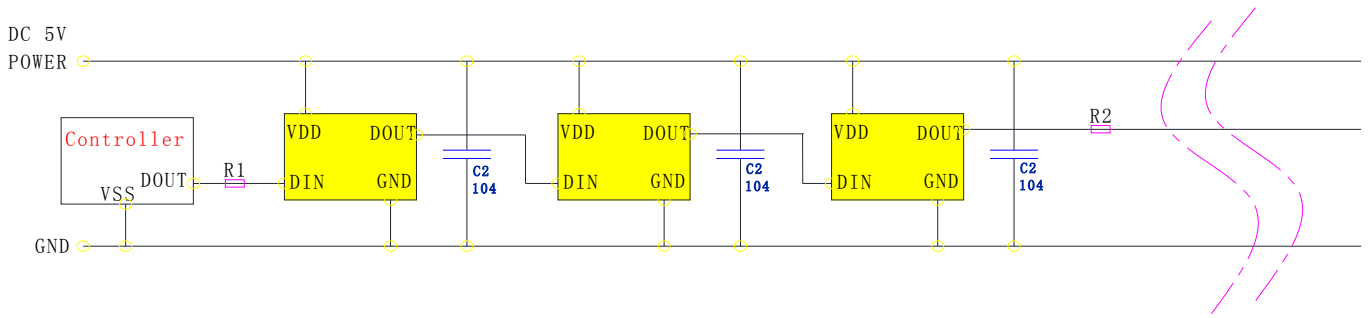
电流增益位 1~16 级时，输出电流值由以下等式设定：

$$I_{OUT}(mA) = 0.8 + 1.1 * (G - 1)$$

其中，G为电流增益1~16级，当G=1时， $I_{out}=0.25$ ，当G=16时， $I_{out}=9mA$

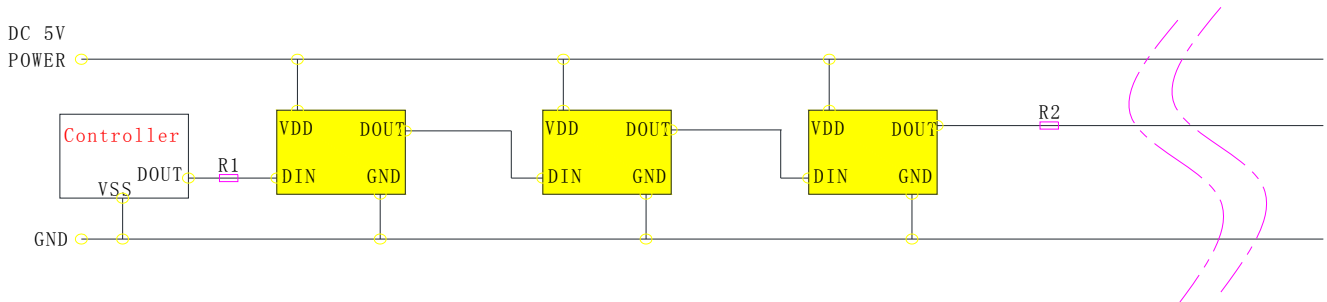
16. 典型应用电路：

典型应用电路一：



免电容版应用电路二：

必须确保产品所用电源没有杂波及尖峰对LED造成损坏；且最大级联LED个数 ≤ 30 Pcs.

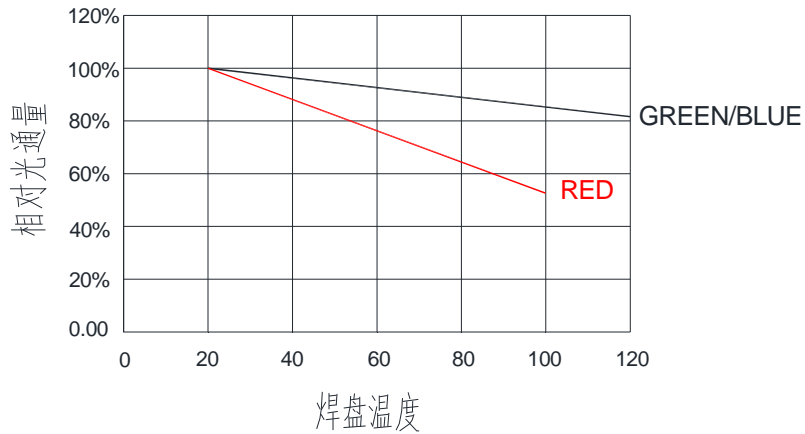


在实际应用电路中，为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部电源及信号输入输出脚，应在信号输入及输出端串接保护电阻。此外，为了使各IC芯片间更稳定工作，各灯珠间的退偶电容则必不可少；

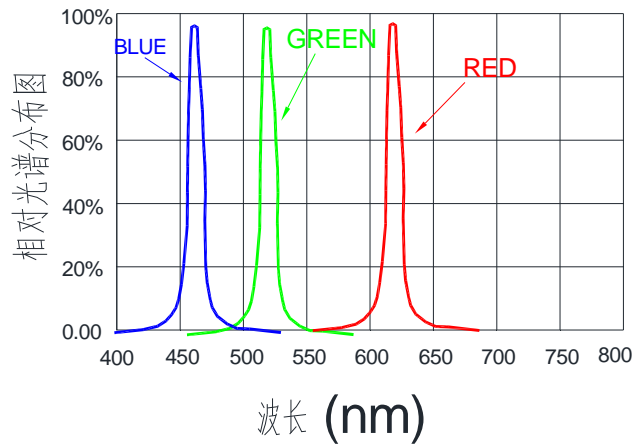
1. 产品两端所并的退偶电容一般不建议省略；必须要省略的话，须确保所用电源符合上述应用电路二所述的要求；
2. 产品的信号输入及输出端必需串接保护电阻R1/R2, 因线材及传输距离不同，在信号线两端串接的保护电阻会略有不同； R1/R2的大小取决于级联灯珠的数量，级联数量越多，则R1/R2越小，灯珠间传输距离长，一般建议在20-2K Ω 之间取值，通常建议取值在500欧左右；以实际使用情况定；

17.光电特性

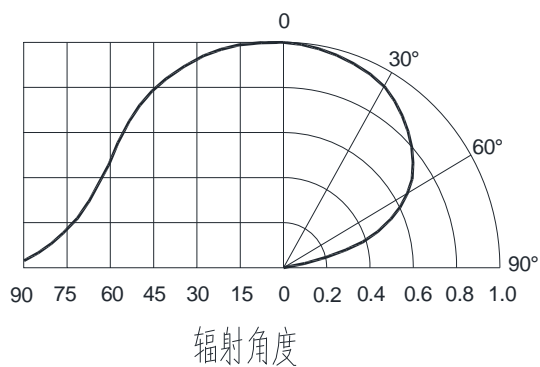
焊盘温度与光通量输出的相对关系



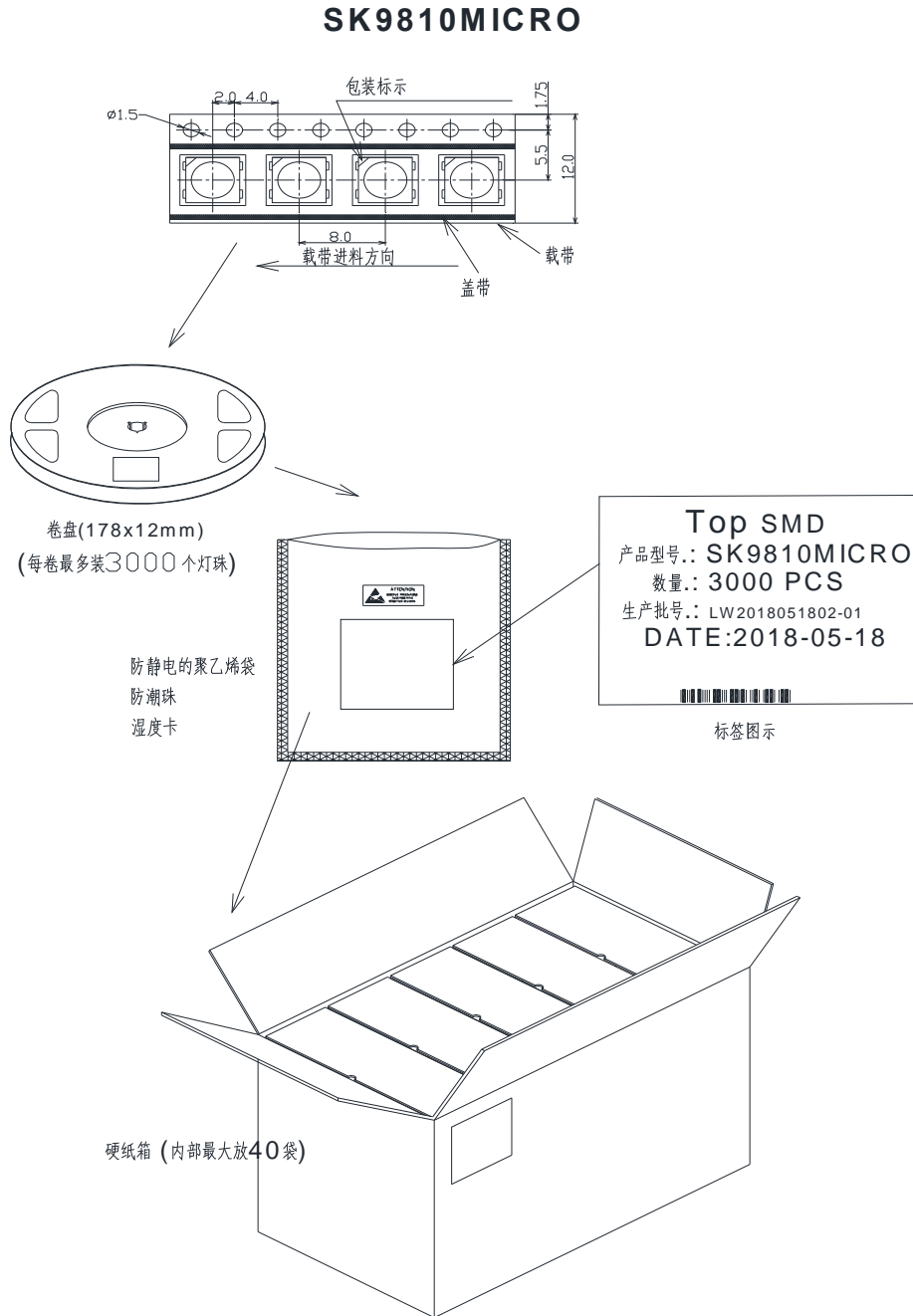
波长特性



典型的辐射方向图 120°



18. 包装标准:



表面贴装LED采用卷盘包装，LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中。纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击，纸箱不防水，因此请注意防潮防水。

深圳市诺曼德电子有限公司

Shenzhen Normand Electronic Co.,Ltd

19. 可靠性测试:

序号	实验项目	实验条件	参考标准	判断
1	冷热冲击	100 ± 5° C ~ -40° C ± 5° C 30min~30min 300cycles	MIL-STD-202G	0/22
2	高温储藏	Ta= +100° C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 201	0/22
3	低温储藏	Ta= -40° C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 202	0/22
4	高温高湿储藏	Ta=60° C RH=90% 1000hrs	JEITA ED-4701 100 103	0/22
5	温度循环	-55° C~25° C~100° C~25° C 30min~5min~30min~5min 100 cycles	JEITA ED-4701 100 105	0/22
6	耐焊接热	Tsld = 260° C, 10sec. 3 times	JEITA ED-4701 300 301	0/22
7	常温寿命测试	25° C, IF: Typical current , 1000hrs	JESD22-A 108D	0/22

失效判定标准:

项目	符号	测试条件	判断标准	
			最小值	最大值
发光强度	IV	DC=5V,规格典型电流	初始数据X0.7	---
耐焊接热	---	DC=5V,规格典型电流	无死灯或明显损坏	

附录1、表面贴装型LED使用注意事项

1. 特点

通过这个资料，达到让诺曼德电子的客户清楚地了解LED的使用方法的目的。

2. 描述

通常LED也与其它电子元件一样有着相同的使用方法，为一让客户更好地使用诺曼德电子的LED产品，请参看下面的LED保护预防措施。

3. 注意事项

3.1. 灰尘与清洁

LED的表面是采用硅树脂封装的，硅树脂对于LED的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。可是，硅树脂质柔软，易粘灰尘，因此，要保持作业环境的洁净。当然，在LED表面有一定限度内的尘埃，也不会影响到发光亮度，但我们仍应避免尘埃落到LED表面。打开包装袋的就优先使用，安装过LED的组件应存放在干净的容器中等。

在LED表面需要清洁时，如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使LED表面溶解等现象。

不可使用具有溶解性的溶液清洁LED，可使用一此异丙基的溶液，在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对LED有溶解作用。

请不要用超声波的方法清洁LED，如果产品必须使用超声波，那么就要评估影响LED的一些参数，如超声波功率，烘烤的时间和装配的条件等，在清洁之前必须试运行，确认是否会影响LED。

3.2. 装运及保存

TOP SMD LED属于湿敏元件，将LED包装在铝膜的袋中是为了避免LED在运输和储存时吸收湿气，在包装袋中放有干燥剂，以吸收袋内的湿气。如果LED吸收了水气，那么在LED过回流焊时，在高温状态下，渗入其中的湿气快速膨胀气化而产生较大的内应力，从而使材料胶裂、分层或损伤键合金丝，造成产品失效。

TOP SMD LED采用具有防潮 防静电的铝箔袋包装，搬运过程中应避免挤压、刺穿包装袋的情形发生，并且做好必要的防静电防护措施；诸产品上线前已发现漏气或破损，请直接停止使用；并做必要的高温除湿动作后使用；产品在转料、贴装过程、及成品出货、安装过程应注意防止外力直接或间接作用于LED灯体，造成外力损伤LED灯珠，造成产品失效；

如上料前，已发现防潮防静电的铝箔袋已拆封、破损、穿孔可及时退回原厂重新进行除湿，绝不可上线使用；

此款产品的湿敏等级为 LEVEL5a。

表一：IPC/JEDEC J-STD-020E 规定的材料防潮等级 (MSL)定义

防潮等级	包装拆封后车间寿命	
	时间	条件
LEVEL1	无限制	≤30°C/85 % RH
LEVEL2	1年	≤30°C/60 % RH
LEVEL2a	4周	≤30°C/60 % RH
LEVEL3	168小时	≤30°C/60 % RH
LEVEL4	72小时	≤30°C/60 % RH
LEVEL5	48小时	≤30°C/60 % RH
LEVEL5a	24小时	≤30°C/60 % RH
LEVEL6	取出即用	≤30°C/60 % RH

深圳市诺曼德电子有限公司

Shenzhen Normand Electronic Co.,Ltd

3.3. 开封前的储存

为了避免由吸湿受潮引发的可靠性失效问题，需做好LED产品SMT前储存与防潮措施；

3.3.1 如果防潮袋没有打开，TOP SMD元件的保存时间为<30°C/60%RH下2个月以内；（注：以标签日期为准，且包装无漏气现象、湿度指示卡防潮珠未变色的前提下使用；针对不同防潮等级材料或包装保存的时间有一定的差异，具体保存时间以规格书或包装袋提示为准）；建议在未装配前不要随意打开防潮袋；

3.3.2 灯珠超过有效保存时间，但未超过包装日期6个月，在使用前需要重新除湿，拆袋烘烤70°C/48H以上，才能使用，除湿完成后烤箱不能断电。使用过程中取一卷贴一卷，未使用的保留在70°C的烤箱中，不能全部材料取出来放在车间中。绝对不能白天除湿，晚上断电烤箱，第二天再进行贴片作业（最长除湿时间不可大于96H，具体除湿烘烤参数参考3.6.2项。）。

3.3.3 灯珠超过包装日期6个月，请退回诺曼德处理。

3.3.4 防潮包装袋有漏气、穿孔或破损等情况，不能烘烤后使用，请退回诺曼德处理。

3.4. 包装袋拆封后的控制

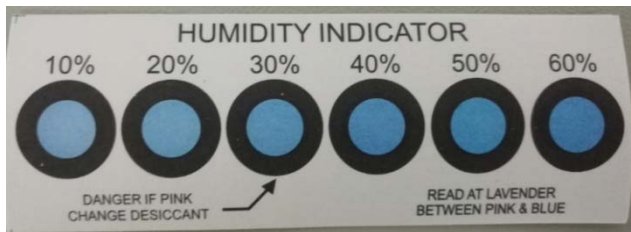
打开防潮袋后，请立即阅读防潮袋内湿度指示卡中的防潮珠是否变为粉红色以确认防潮袋中的湿气是否过多，根据防潮珠的颜色以判定此袋材料是否可以上线作业；且打开包装后材料应严格控制在表一所规定的最大温湿度及操作时间允许范围内，只要材料暴露在表一所述的环境中，则需累计其在车间的使用时间。打开包装袋后并贴在PCB板上的材料，应在

0.5H内完成焊接工作，不建议将材料贴在PCB上，长时间呆置在车间内不进行SMT过炉作业；以免材料吸收锡膏内水分造成不良引患；

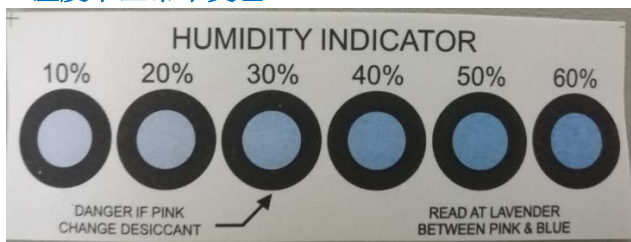
3.5. 湿度卡的定义

拆开包装后TOP SMD LED包装袋内湿度卡颜色指示处理方式如下：

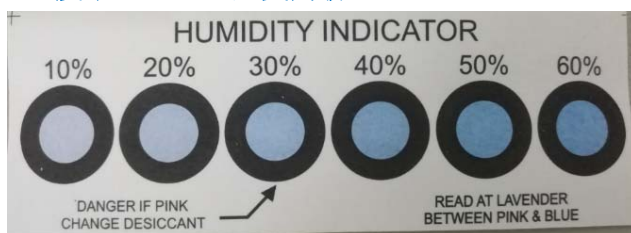
- 如果湿度卡防潮珠10%处变为粉红色，其它档为蓝色，此种情况，LED可以直接使用；
- 如果湿度卡防潮珠10%、20%处均变为粉红色，其实档为蓝色，此种情况，需对元件进行低温烘烤除湿；
- 如果湿度卡防潮珠10%、20%、30%三处以上均变为粉红色，此种情况下，客户需将材料寄回我司进行高湿除湿，重新包装后方可使用；



湿度卡正常未变色



湿度卡10%、20%处变为粉红色



湿度卡10%、20%、30%处变为粉红色

3.6. 未使用完的材料防潮保存 及 已完成装配的材料防潮控制

3.6.1 如果一卷SMD材料未一次性用完，且车间温湿度在限定之条件 ($<30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$)内，元件在空气中暴露时间未超出2H,则余下材料应于干燥剂一起进行抽真空密封保存，否则，材料必须低温烘烤除湿；除湿后的材料重新包装可重新开始计算时间；对已完成装配的SMD元件进行防潮控制

- a. 对已装配到PCB板后的元件不需再经过高温工序或回流焊工艺，则将不作特殊处理；
- b. 对需要做灌胶、滴胶或包胶防护处理的产品，建议产品在做相应防护工艺前做好必要的除湿工作，在 $70^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的烤箱中烘烤不少于48小时，以剔除产品在检测、老化过程中暴露在空气中吸收的水分，以避免产品在做防护处理后，包在材料表面的湿气会慢慢侵入产品，会造成产品失效（具体除湿烘烤参数参考3.6.2项）；
- c. 对需要进行二次SMT工艺或高温的产品，在完成一次焊接后将会进行二次焊接前，亦应做好必要的防潮处理，暴露在 ($<30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$) 条件下，最长不可超过4H,若二次高温工艺相隔时间较长，则一次焊接后的材料必需进行必要的除湿工作（在 $70^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的烤箱中烘烤不少于48小时），然后抽真空密封保存；或者先将产品贮存在干燥箱内或带有干燥剂的容器内，二次高温工艺前，再做除湿工作（在 $70^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的烤箱中烘烤不少于48小时），以确保产品在过高温工艺前不受潮（具体除湿烘烤参数参考3.6.2项）；

低温烘烤条件： $70^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 烘烤不小于48小时

高温烘烤条件： $130^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 烘烤不小于6小时（灯珠必需拆成散粒）

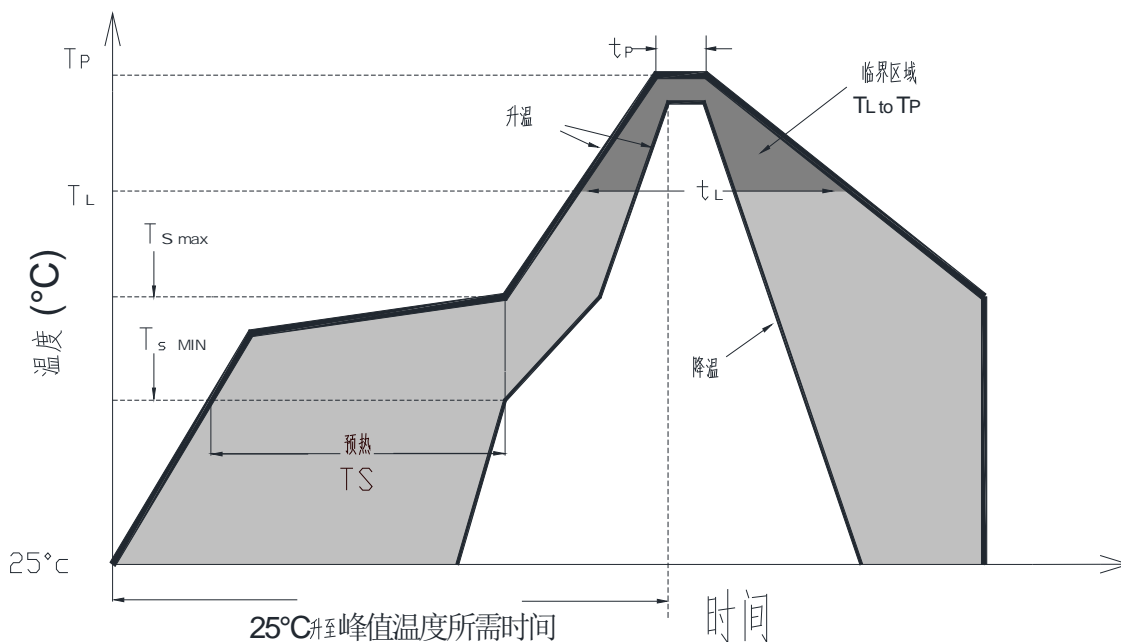
3.6.2 低温/高温除湿对应环境湿度与除湿时间关系表：

环境湿度	烤箱温度	烘烤时间	烘烤方式
40%	70°C	24H	从静电袋中取出，与卷盘一起烘烤除湿
50%	70°C	48H	从静电袋中取出，与卷盘一起烘烤除湿
$>60\%$	70°C	无效除湿烘烤	无效除湿烘烤
40%	130°C	6H	灯珠必需拆成散粒烘烤除湿
50%	130°C	12H	灯珠必需拆成散粒烘烤除湿

3.7. 回流焊接

经诺曼德电子采用下面所列参数检测证明，表面贴装型LED符合JEDEC J-STD-020E 标准。作为一般指导原则，诺曼德电子建议客户遵循所用焊锡膏制造商推荐使用的焊接温度曲线。

请注意此一般指导原则可能并不适用于所有PCB设计和回流焊设备的配置。

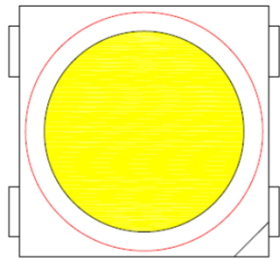


温度曲线特点	含铅焊料	无铅焊料
平均升温速度 ($T_{s_{max}}$ 至 T_p)	最高3℃/秒	最高3℃/秒
预热：最低温度 ($T_{s_{min}}$)	100℃	150℃
预热：最高温度 ($T_{s_{max}}$)	150℃	200℃
预热：时间 ($t_{s_{min}}$ 至 $t_{s_{max}}$)	60-120 秒	60-180 秒
维持高温温度的时间：温度 (T_I)	183 ℃	217 ℃
维持高温温度的时间：时间 (t_I)	60-150 秒	60-150 秒
峰值/分类温度 (T_p)	215 ℃	240 ℃
在实际峰值温度 (t_p)5℃内的时间	<10 秒	<10 秒
降温速度	最高6℃/秒	最高6℃/秒
25 ℃升至峰值温度所需时间	最多6分钟	最多6分钟

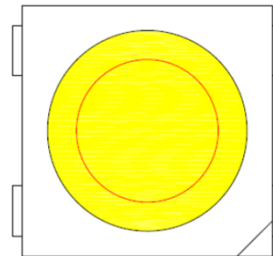
注：所有温度是指在封装本体上表面测得的温度。

3.8. 一般使用设计要求

· SMT吸嘴要求：（红色圆圈指吸嘴内径）

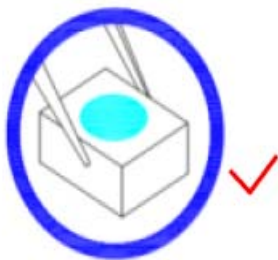


OK(吸嘴内径大于灯珠发光区)

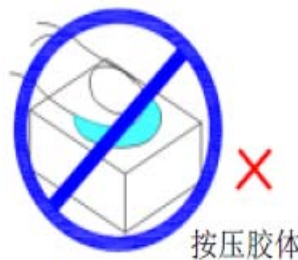


NG (吸嘴内径小于灯珠发光区)

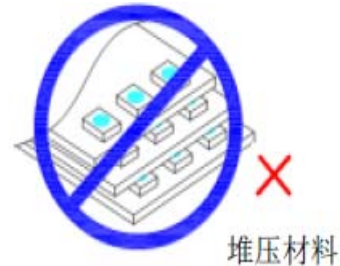
· 材料取拿方式：用镊子夹取材料，不可按压胶体或尖锐物体碰刺胶体，材料不可堆叠放置；



OK 正确的拿取方式



按压胶体



堆压材料

NG 错误的拿取方式

· 产品在进行PCB布线设计时，针对软性板材、及0.5T以下板材，焊盘走向应与PCB延展方向保持垂直状态，以减少PCB板弯折时产生之应力作用在LED引脚，造成LEDs产品因应力作用拉伸产生失效隐患；

3.9. 热量的产生及设计要求

- . 对于LED产品，散热方面的设计是很重要的，在系统设计时请考虑LED所产生的热量，PCB板的热阻、LED放置的密度和相关组成，以及输入的电功率都会使温度增加。
- . 为避免出现过多热量的产生，须保证LED运行时要在产品规格书中所要求的最大规格范围之内。在设定LED的驱动电流时，应考虑到最高的环境温度。
- . 产品最高工作温度不易超过60°C(即≤60°C,指产品引脚处的工作温度)

4.0. IC器件的防静电及电涌防护

- . 静电和电涌会伤害到IC器件的LED产品，因此，必须做好相应的防护措施；
- . IC器件的信号输入输出端口必段串接防护电阻以防电涌或静电冲击端口造成产品失效；
- . 为保护好IC器件的LED产品，无论什么时间与场合，只要接触到LED时，都要穿带防静电手带，防静电脚带及防静电手套
- . 所有的装置和仪器设备均须接地
- . 建议每一种产品在出货前检验时，都应有相关电性测试，以挑选出因静电而产生的不良品
- . 在电路设计时，应考虑消除电涌对LED危害的可能性。

4.1. 其它

如果超出规格书以外而进行使用时，出任何问题我们都将不承担责任。

LED可以发出很强的足以伤害到眼睛的光，要注意预防，不可过长时间用肉眼直视LED的光。

在大量使用之前，应与我们交流，了解更详细的规格要求。

LED产品形状和规格如有改变，请恕不能及时相告。